

第 127 回研究会

2013 年度精密工学会秋季大会学術講演会 オーガナイズドセッション「プラナリゼーション CMP とその応用」

開催場所: 関西大学 千里山キャンパス

プラナリゼーション CMP とその応用(1)

9月12日 9:00~10:20 Q室

Q01・Q02 (キーノートスピーチ)

大型高品質単結晶ダイヤモンドの高圧合成と欠陥制御

○角谷 均 (住友電気工業)

Q03

先端的難加工材料の高効率精密加工法の研究 (第3報) -fs レーザ 照射による疑似ラジカル場形成ダイヤモンド基板とその基本的加工特性-

○大山幸希 (並木精密宝石) ・土肥俊郎・黒河周平 (九州大) ・佐野泰久 (大阪大) ・曾田英雄 (並木精密宝石) ・高橋邦充 (ディスコ) ・武田秀俊 (並木精密宝石) ・塚本敬一・紀 文勇・山崎 努 (九州大) ・小山浩司 (並木精密宝石)

Q04

先端的難加工基板の高効率精密加工法の研究 (第5報) -fs レーザ照射による疑似ラジカル場形成の検討-

○黒河周平・王 成武・駒井信一 (九工大) ・曾田英雄・大山幸希 (並木精密宝石) ・高橋邦充 (ディスコ) ・佐野泰久 (大阪大) ・塚本敬一・土肥俊郎 (九工大)

プラナリゼーション CMP とその応用(2)

9月12日 10:40~12:00 Q室

Q06

先端的難加工基板の高効率精密加工法の研究 (第4報) -加工変質層の断面 TEM による評価とその PCVM 加工特性-

○塩澤昂祐・佐野泰久 (大阪大) ・土肥俊郎・黒河周平 (九州大) ・曾田英雄 (並木精密宝石) ・大西 修 (宮崎大) ・畝田道雄 (金沢工大) ・岡田 悠・山内和人 (大阪大)

Q07

SiC 単結晶の酸化剤援用研磨の研究 (2)

○大森 恒・佐藤 誠・高橋舞子 (ノリタケカンパニーリミテド)

Q08

純水を用いた化学エッチングによる 4H-SiC 基板の平坦化加工

○磯橋 藍・佐野泰久・定國 峻・山内和人 (大阪大)

Q09

CMP における研磨装置の挙動解析と研磨特性の関係

畝田道雄・○高橋佳宏 (金沢工大) ・渋谷和孝・中村由夫・市川大造 (不二越機械工業) ・石川憲一 (金沢工大)

プラナリゼーション CMP とその応用(3)

9月12日 13:00~14:20 Q室

Q13・Q14 (キーノートスピーチ)

CMPプロセスにおける表面基準研磨技術の検証

○藤田 隆 (東京精密)

Q15

ポリシャの表面粗さがピン支持された基板の研磨にあたる影響

○松井伸介 (千葉工大) ・宇根篤暢 ((元) 防衛大)

Q16

グリーンデバイス用結晶基板の加工プロセス技術の研究開発 (第4報) —ダイラタンシー特性を有する高プレストン係数パッドによる難加工材料の超精密加工特性—

○瀬下 清・土肥俊郎・大坪正徳・山崎 努・紀 文勇・若林豊博 (九州大)

プラナリゼーション CMP とその応用(4)

9月12日 15:00~16:00 Q室

Q19

スラリー循環型工具を用いた高能率 CMP (第3報) —従来型溝パターン工具の研磨特性との比較—

○平井洋介・吉富健一郎・餅田正秋・宇根篤暢 (防衛大)

Q20

ファイバードレッサによるドレッシング安定性の評価

○新井雄太郎 (昭和工業) ・高橋直紀 (金沢工大) ・藤田 隆 (東京精密) ・畠田道雄 (金沢工大)

Q21

マイクロバブルと紫外線照射による高効率 CMP に関する研究

○長岡敦志・パナートカチョンルルアン (九工大) ・木村景一 (NTUST) ・鈴木恵友 (九工大)

プラナリゼーション CMP とその応用(5)

9月12日 16:20~17:20 Q室

Q23

ウェットエッチング PSS のパターン形状制御メカニズム

○青田奈津子・会田英雄・木村 豊・川又友喜 (並木精密宝石) ・畠田道雄 (金沢工大)

Q24

噴霧熱分解合成シリカ粒子によるサファイア研磨特性

○川原浩一 (ファインセラミックスセンター) ・須田聖一 (静岡大)

Q25

サファイア CMP の研磨レートに及ぼすスラリーフローの影響

畝田道雄・○福田有哉（金沢工大） ・伊藤康昭・堀田和利・玉井一誠・森永 均（フジミインコーポレーテッド） ・石川憲一（金沢工大）